T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

# Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> METAL CAM FİLMİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ELEKTROKİMYASAL **EMPEDANS YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Pınar ŞAHİN

Enstitü Anabilim Dalı : FİZİK

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan Şentürk

Haziran 2009

### T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

# Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> METAL CAM FİLMİNİN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ELEKTROKİMYASAL EMPEDANS YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Pınar ŞAHİN

Enstitü Anabilim Dalı

: FİZİK

Tez Danışmanı

: Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ŞENTÜRK

Bu tez 18/06/2009 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Prof. Dr. Hüseyin Murat TÜTÜNCÜ Jüri Başkanı

rd. Doc. Dr.

Ýrð. Doç. Dr. Erdogan ŞENTÜRK Üye

Yrd. Doç. Dr.

Yrd. Doç. Dr. Yılmaz UYAROĞLU Üye

## ÖNSÖZ

Her ikisinin de katı madde oluşu bir yana bırakılırsa, cam ve metal neredeyse hiç ortak özelliği yokmuş gibi görünen iki ayrı malzemedir. Cam, kırılganlığı ve saydamlığı ile öne çıkarken, metal dayanıklılığı ve iletkenliği temsil eder.

1957 yılında Au<sub>80</sub>Si<sub>20</sub> metal alaşımından Pol Duwez tarafından elde edilen ilk metalik cam, bu anlamda ön yargıları tamamen yok ederek malzeme bilimcilere yeni bir ufuk açmıştır. Makro boyutta metale, mikro boyutta ise cama yakın olan bu malzeme, bilim dünyası için önemini ve gizemini günümüzde de korumaya devam etmektedir.

Eriyik durumdaki metal alaşımını, kristal oluşumuna izin vermeyecek bir hızla soğutma prensibiyle üretilen metalik camlar, teknoloji alanında da bir çok arayışa cevap vermektedir.

Bu çalışma, bu arayışlara katkı sağlamak amacıyla Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> metal alaşımından elde edilen metalik camın bazı elektriksel özelliklerinin oda sıcaklığında 1 kHz -1 MHz frekans aralığında elektrokimyasal empedans spektroskopi yöntemiyle incelenmesi amacı üzere hazırlanmıştır.

## TEŞEKKÜR

Tez çalışmamın konusunu bana teklif eden, çalışmanın her aşamasında bilimsel birikimi ve deneyimleriyle yanımda olan sayın hocam Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ŞENTÜRK'e...

Malzeme ölçümlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğum ortam ve deney düzeneklerini sağlayan, fakültemizin Kimya bölümü hocalarından Sayın Doç. Dr. Mehmet KANDAZ'a...

Çalışmamı yazıya geçirirken kullandığım dili anlaşılabilir, duru ve güzel bir hale getirmem konusunda destek olan babam Eğitimci-Yazar Süleyman ŞAHİN'e...

Beni çalışmalarımla ilgili yüreklendiren, her konuda yardım ve desteklerini yanımda hissettiğim annem Safiye ŞAHİN ve nişanlım Mehmet CAN'a sonsuz minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

# İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	ii
TEŞEKKÜR	iii
İÇİNDEKİLER	iv
ŞEKİLLER LİSTESİ	vii
TABLOLAR LİSTESİ	Х
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ	xi
ÖZET	xiii
SUMMARY	xiv

## BÖLÜM 1.

GİRİŞ 1
---------

## BÖLÜM 2.

METALİK	C.	AMLARIN	TANIMI,	ÖZELLİKLERİ,	ÜRETİM	
TEKNİKL	ERİ V	E TARİHİ GEL	LİŞİMİ			3
2.1.	Metal	ik Camların Ta	nımı ve Özell	ikleri		3
2.2.	Metal	ik Cam Üretim	Teknikleri			6
,	2.2.1.	Soğuk dönen d	lisk metodları.			6
		2.2.1.1. Sıvı m	etal savurma	metodu		7
		2.2.1.2. Düzler	nsel akışlı döl	küm metodu		8
	2.2.2.	Sıvı metal çeki	me metodu		•••••	9
,	2.2.3.	Sıvı metal üstt	en akıtma met	odu		9
,	2.2.4.	Sıvı metal fırla	tma metodu .		•••••	10
2.3.	Metal	ik Camların Ta	rihi Gelişimi			11

## BÖLÜM 3.

Fe <sub>78</sub> Si <sub>9</sub> B <sub>13</sub> İLE İLC	HLİ YAPILMIS LİTI	ERATÜR CALISMALARI	13
10/0019013 100 100	, and the many bits		10

3.1. Fe <sub>78</sub> Si <sub>9</sub> B <sub>13</sub> ile İgili Çalışmalara Genel Bakış	13
3.1.1. Amorf metal alaşımı Fe78Si9B13'ün düşük frekanslı	
manyetik alanda davranışı	13
3.1.2. $Fe_{78}Si_9B_{13}$ alaşımının sülfat ve klorid çözeltisinde	
elektrokimyasal davranışı	14
3.1.3. Amorf $Fe_{78}Si_9B_{13}$ şeridinin ısı artışı ve akım uygulamasında	
meydana gelen yapısal değişiklik	17
3.1.4. $Fe_{78}Si_9B_{13}$ toz parçacıkları içeren nanokompozit	
polimerlerin ferromagnetik özellikleri	19
3.1.5. Amorf Fe <sub>78</sub> Si <sub>9</sub> B <sub>13</sub> 'ün farklı sabit sıcaklıklarda bekletilme	
sürecindeki durumu	22
3.1.6. Sabit sıcaklıkta bekletilme sürecinde $Fe_{78}Si_9B_{13}$ amorf	
malzemesinin kırılganlığa geçişi	23
3.1.7. Farklı sabit sıcaklıklarda bekletilen $Fe_{78}Si_9B_{13}$ metalik	
camının manyetik yapısında ve mikro yapısında meydana	
gelen değişimlerin gözlemlenmesi	24
3.1.8. Amorf $Fe_{78}Si_9B_{13}$ şeritlerinin nanokristalizasyon davranışı	
ve manyetik özellikleri	27
3.1.9. $Fe_{78-x}Mo_xSi_9B_{13}$ amorf alaşımlarının kristalizasyon	
çalışması	30

## BÖLÜM 4.

Fe <sub>78</sub> Si <sub>9</sub> B <sub>13</sub> 'ÜN DENEYSEL SİSTEMİ VE ÖLÇME TEKNİĞİ	34
4.1. Elektrokimyasal Empedans Kavramı	34
4.2. Fe78Si9B13 Metalik Camının Deneye Hazırlanması	38
4.3. Fe78Si9B13 Metalik Camının Elektriksel Özelliklerinin Ölçümünde	
Kullanılan Deney Düzeneği	38
4.3.1. Empedans analizörü	38
4.3.2. Flat cell	40
4.3.3. Bilgisayar ve yazılım	40
4.4. Deneyin Uygulanması	41

BÖLÜM 5.

EMPEDANS ÖLÇÜMLERİ	42
5.1. Empedans Çalışması	42
5.2. RC Devre Çalışması	48
5.3. İletkenlik Çalışması	50
BÖLÜM 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER	54
KAYNAKLAR	56
ÖZGEÇMİŞ	58

# ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1.	Sıvı, cam ve katı fazlar için, hacmin sıcaklıkla değişimi	3
Şekil 2.2 .	Gaz, sıvı, amorf ve kristal yapılı katının X-ışını deney sonuçlarından elde edilmiş $I(\theta)$ şiddet piklerinin ve atomik	
	pozisyonarinin şematik gösterini	5
Şekil 2.3.	S1v1 metal savurma metodu	7
Şekil 2.4.	Düzlemsel akışlı döküm metodu	8
Şekil 2.5.	S1v1 metal çekme metodu	9
Şekil 2.6.	Metal üstten akıtma metodu	9
Şekil 2.7.	Metal fırlatma metodu	10
Şekil 3.1.	Amorf metal alaşımı $Fe_{78}Si_9B_{13}$ 'ün, manyetik alan	
	uygulanmasından önceki ve sonraki Mössbauer Spektroskopisi	14
Şekil 3.2.	Farklı sıcaklıklarda 0,5 M $Na_2SO_4$ içinde elde edilen $Fe_{73}Si_{13}B_9$	
	alaşımının korozyon oranı ve sıcaklığa bağımlılığı	15
Şekil 3.3.	0,5 M Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> çözeltisi içinde Fe <sub>73</sub> Si <sub>13</sub> B <sub>9</sub> 'ün 350-550 °C'de	
	sıcaklık davranışı ve as-quenchede karşı gelen potansiyedinamik	
	polarizasyon eğrisi	16
Şekil 3.4.	Farklı sıcaklık oranlarında ölçülen amorf $Fe_{73}Si_{13}B_9$ as-quenched	
	şeritlerinin DSC termogramı	17
Şekil 3.5.	Farklı sıcaklık oranlarında ölçülen amorf $Fe_{73}Si_{13}B_9$ as-quenched	
	şeritlerine ait DSC termogramının sol tarafı	18
Şekil 3.6.	Farklı sıcaklık oranlarında ölçülen amorf $Fe_{73}Si_{13}B_9$ as-quenched	
	şeritlerinin termal genleşme eğrileri	18
Şekil 3.7.	Farklı sıcaklık oranlarında ölçülen amorf Fe <sub>73</sub> Si <sub>13</sub> B9 as-quenched	
	şeritlerinin termal genleşme katsayıları	19
Şekil 3.8.	Fe <sub>73</sub> Si <sub>13</sub> B <sub>9</sub> elenmiş tozlarının A) 200-500 μm B) 75-200 μm	
-	C) 25-75 µm aralıklarında çekilmiş SEM fotoğrafları	20

Şekil 3.9.	Bileşik çekirdeklerin ters çevirici alanda toz taneciklerinin	
	hacminin etkisi	20
Şekil 3.10.	Bileşik çekirdeklerin doyum indüksiyonunda toz taneciklerinin	
	hacminin etkisi	21
Şekil 3.11.	Bileşik çekirdeklerin manyetik geçirgenliğinde toz taneciklerinin	
	hacminin etkisi	21
Şekil 3.12.	Farklı soğutma süreçlerinde bekletilen amorf $Fe_{73}Si_{13}B_9$	
	şeritlerinin XRD desenleri	22
Şekil 3.13.	Soğutma sıcaklığı ve amorf $Fe_{73}Si_{13}B_9$ şeridinin dış kenarının	
	basınçla arasındaki ilişki	23
Şekil 3.14.	Gerilme baskısı uygulayarak kırılan amorf Fe73Si13B9	
	şeritlerinin kırılma yüzeylerinin SEM mikrografiği	
	i) Esnek durum : a) as-quenched b) 1 saatte 200 °C bekletilme	
	durumunda c) 1 saatte 250 °C bekletilme durumunda	
	ii) Kırılgan durum : d) 1 saatte 275 °C bekletilme durumunda	
	e) 1 saatte 300 °C bekletilme durumunda f) 2 saatte 250 °C	
	bekletilme durumunda	24
Şekil 3.15.	METGLAS-2605 S2'nin 773 K sabit sıcaklık altında bekletilme	
	zamanına karşılık gelen H <sub>c</sub>	25
Şekil 3.16.	773 K de bekletilen $Fe_{78}Si_9B_{13}$ örneğinin as-recived M-H halkası	25
Şekil 3.17.	773 K de bekletilen Fe78Si9B13 örneğinin XRD desenleri	26
Şekil 3.18.	As-cast Fe73Si13B9 şeritlerinin tipik domen resimleri	
	a) ve b) sabit sıcaklıkta bekletme işlemi öncesi	
	c) 3 dakika sabit sıcaklıkta bekletme işleminden sonra	
	d) 10 dakika sabit sıcaklıkta bekletme işleminden sonra	26
Şekil 3.19.	773 K'de a) 35 dakika b) 50 dakika annealing işlemine tabî	
	tutulan $Fe_{73}Si_{13}B_9$ metalik camının tipik manyetik domenleri	27
Şekil 3.20.	Farklı ısıtma oranlarında Fe73Si13B9 amorf şeritleri için DSC	
	eğrileri	28
Şekil 3.21.	1 K/dakika ısıtma oranında ve 0 Dopler hızında 10 s için	
	sıcaklığın fonksiyonunun ölçümü	28
Şekil 3.22.	Farklı bekleme sıcaklıklarından sonra $Fe_{73}Si_{13}B_9$ amorf	
	şeritlerinin XRD desenleri	29

Şekil 3.23.	Farklı sıcaklıklarda Fe73Si13B9 şeritlerinin Mössbauer Spektrumu	29
Şekil 3.24.	$Fe_{73}Si_{13}B_9$ amorf şeridinin azaltılan sıcaklığa karşı azalan	
	manyetizasyonu ve kristalizasyondan sonra oluşan kristalleşme	
	fazları	30
Şekil 3.25.	Karışımın atomik konsantrasyonu ve sıcaklığın fonksiyonu	
	olarak metal alaşımının azaltılan doyma manyetizasyonu	31
Şekil 3.26.	Karışımın atomik konsantrasyonu ve sıcaklığın fonksiyonu	
	olarak metal alaşımının elektriksel direncinin yüzde değişimi	31
Şekil 3.27.	475 °C de bekletilen metal alaşımlarının doyma manyetizasyonu	32
Şekil 3.28.	Çeşitli atomik konsantrasyonlarda Mo'in kristalleşme oranının	
	sıcaklıkla değişimi	32
Şekil 3.29.	İlk kristalizasyonun aktivasyon enerjisi ve pro-exponansiyel	
	sıklık faktörü	33
Şekil 4.1.	Sinüsodial bir sistemde sinüsodial akım yanıtı	35
Şekil 4.2.	Lissajous eğrisi	36
Şekil 4.3.	Empedansın imajiner kısmının reel kısmına bağımlılığı	37
Şekil 4.4.	Tek zaman sabitli devrenin beklenen yanıt grafiği	37
Şekil 4.5.	Allied Corporation USA tarafından üretilen Fe78Si9B13 metalik	
	cam şeridi	38
Şekil 4.6.	Princeton Applied Research firması tarafından üretilen	
	"PARSTAT 2273" Empedans Analizörünün önden görünümü	39
Şekil 4.7.	Princeton Applied Research firması tarafından üretilen	
	"PARSTAT 2273" Empedans Analizörünün arkadan görünümü	39
Şekil 4.8.	Princeton Applied Research firması tarafından üretilen "FLAT	
	CELL" adlı frekans değişimi iletim mekanizması	40
Şekil 4.9.	Princeton Applied Research firması tarafından üretilen	
	PowerSINE adlı yazılımın kullanıcı arayüzü	41
Şekil 5.1.	Empedansın reel kısmının frekans bağımlılığı	43
Şekil 5.2.	Empedansın imajiner kısmının frekans bağımlılığı	45
Şekil 5.3.	Fe <sub>78</sub> Si <sub>9</sub> B <sub>13</sub> için Cole-Cole Eğrisi	47
Şekil 5.4.	R-C eşdeğer devre modeli	48
Şekil 5.5.	Fe <sub>78</sub> Si <sub>9</sub> B <sub>13</sub> için farklı DC voltajlarında log $\sigma$ 'e karşı log $\omega$ 'nın	
	bağımlılığı	51

# TABLOLAR LİSTESİ

Tablo 2.1.	Metalik camlar ile kristal yapılı malzemelerin karşılaştırılması	4
Tablo 5.1.	Fe78Si9B13 için fit işlemi ile elde edilen parametreler	50
Tablo 5.2.	Frekansa bağlı iletkenlik formülünün deneysel datalarla fitinden	
	elde edilen parametreler	53

# SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ

AC	: Alternatif akım
AGM	: Değişimli gradyant manyetometresi
α	: Pro-eksponansiyel faktör
BCC	: Hacim merkezli kübik kristal yapı
СВН	: Bir enerji bariyerinden zıplama ile özdeşleşmiş iletkenlik modeli
С	: Çift katmanlı kapasitans
$C_{0}$	: Geometrik kapasitans
DC	: Doğru Akım
DSC	: Diferansiyel taramalı kalorimetre
е	: Elektronun yükü
$\boldsymbol{\varepsilon}^{*}(w)$	: Kompleks dielektrik sabiti
$\mathcal{E}'$	: Dielektrik sabitinin reel kısmı
$\mathcal{E}^{''}$	: Dielektrik sabitinin imajiner kısmı
$\epsilon_0$	: Düşük sıcaklıklarda dielektrik sabiti
€∞	: Yüksek sıcaklıklarda dielektrik sabiti
$\phi$	: Faz farkı
$R_s$	: Çözeltinin direnci
$R_p$	: Paralel direnç
R	: İletkenliğe katkı verecek elektronların hoplama mesafesi
T <sub>m</sub>	: Metalin ergime sıcaklığı
Tg	: Faz geçiş sıcaklığı
T <sub>g1</sub>	: Sıvı için faz geçiş sıcaklığı
T <sub>g2</sub>	: Cam için faz geçiş sıcaklığı
$ au_{0}$	: Relaksasyon zamanı

τ	: Fonon relaksasyon zamanı
VSM	: Titreşimli örnek manyetometresi
$Z^{*}$	: Kompleks empedans
Z'	: Empedansın reel kısmı
$Z^{\prime\prime}$	: Empedansın imajiner kısmı
$W_m$	: Elektronların sıçrayabileceği maksimum bariyer yüksekliği
W <sub>p</sub>	: Sıçrama frekansı
XRD	: X-ışını kırınımı
σ	: İletkenlik

## ÖZET

Anahtar Kelimeler : Metalik cam, Empedans, İletkenlik

Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>, oda sıcaklığında ve 1 kHz – 1 MHz frekans aralığında Elektrokimyasal Empedans Spektroskopi yöntemiyle çalışıldı. Malzemenin, DC Bias voltaj altında elektriksel özelliklerinin karakteristik değişimleri analiz edilmek üzere Cole-Cole diyagramları kullanıldı.

Çalışmada kullanılan numuneler, şeritlerin en kusursuz kısımlarından alındı. Amorf alaşım Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeritleri 20 mm genişliğinde, 50 mm uzunluğunda ve 20  $\mu$ m kalınlığındaydı. EIS dataları üç elektrotlu PARSTAT 2273 model empedans analizörü kullanılarak elde edildi. AC empedans A K0235 model flat cell kullanılarak iletildi.

Metalik camın empedans davranışı, elektriksel eşdeğer devre ile modellendi. Eşdeğer devre, indüktör içermeyen direnç ve kapasitörden oluşan bir RC devresi olarak düşünüldü. İletkenlik spektrumu bir DC düzlüğü ve bir dağınık bölge ortaya çıkardı. Bu durum "Bir Enerji Bariyerinden Zıplama ile Özdeşleşmiş İletkenlik Modeli" (CBH) ile açıklandı.

### ELECTRICAL CHARACTERIZATION OF Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> METAL GLASS FILM WITH ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY

### SUMMARY

Key Words : Metallic glass, Impedance, Conductivity

Electrochemical Impedance Spectroscopic studies were carried out on  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  system at room temperature in the frequency range from 1 kHz to 1 MHz. Cole–Cole plots are used to analyze the characteristic changes of electrical properties under DC Bias voltage.

The sample which was used in the experiments were taken from the best part of the ribbons. Amorphous alloy  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  ribbons were 20 mm width, 50 mm length and 20  $\mu$ m thickness. The EIS data were collected using a PARSTAT 2273 system with a three electrode configuration. A K0235 model flat cell was used conductivity was determined by AC impedance.

The impedance behaviour of the metallic glass is modeled by an equivalent electrical circuit. We show that there exists a class of mechanisms involving adsorption reactions that must have an RC equivalent circuit, a circuit with resistors and capacitors but no inductors. The conductance spectrum reveals a DC plateau and a dispersive region that suggest Correlated Barrier Hopping (CBH) mechanism.

## **BÖLÜM 1. GİRİŞ**

Cam, günlük yaşam içerisinde ne kadar sıradan bir malzeme gibi görünse de bilim dünyası için önemini, gizemini ve geliştirilme çabalarını halen korumaya devam etmektedir.

Princeton Üniversitesi kimyacıları, sıvı bir maddenin katı hale dönüştürülmek üzere ne kadar hızla soğutulduğuna bağlı olarak camın her seferinde farklı bir şekilde oluştuğunu söylemektedirler. Princeton ekibinden Sal Torquato "Camlar, bütün maddelerden oluşturulabilir." demektedir. Moleküllerin birbiriyle etkileşim biçimleri, onları sıvılarla katılar arasında bir yere koymakla birlikte üreticilerin yararlanacağı türden özellikler kazandırıyor. Sözgelimi, baş kısmı metalik camdan yapılmış bir golf sopası, topun daha uzağa gitmesini sağlayabilir [1].

Benzer çabalar Beijing Fizik Enstitüsünde de görülmektedir. Wei Hua Wang ve ekibince geliştirilen bir malzeme oda sıcaklığında bir metalin sertliğine, dayanıklılığına ve elektrik geçirgenliğine sahipken ısıtılıp 68 °C'e geldiğinde sıkılıp yoğurulabilecek ve şekil verilebilecek bir malzeme haline geliyor. Wang'ın seryum, alüminyum ve bakırdan meydana getirdiği çok az da niobyum içeren amorf malzemesi cama geçiş sıcaklığının düşüklüğü ve kristalleşmeye karşı direnciyle birleşince çok farklı kullanım alanları için ideal hale geliyor [2].

Bu güncel örneklerden de anlaşılacağı gibi, çalışma metalik camlar ya da bilim çevrelerindeki yaygın adıyla metglasslar üzerine geliştirildi. Metalik camlar içerisinde % 78 demir, % 9 silisyum ve % 13 bordan oluşan (Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>) metalik cam ve bunun elektriksel özelliklerinin elektrokimyasal empedans spektroskopi yöntemiyle incelenmesi, çalışmanın ana çerçevesini oluşturuyor.

Ayrıntılara geçmeden önce çalışma konusu malzemenin de içinde bulunduğu "metalik cam" grubundan biraz bahsetmek uygun olur. Bu nedenle ikinci bölümde metalik camların tanımı, özellikleri, üretim teknikleri ve çalışmaların ilk başladığı 1930'lardan bugüne gelişim süreci anlatılmaktadır.

Üçüncü bölümde bugüne dek  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  için yapılmış ölçüm çalışmalarından yayınlanmış makalelerden ve bu çalışmalarda edinilen sonuçlardan bahsedilmektedir.

Dördüncü bölümde, çalışmada kullanılan elektrokimyasal empedans spektroskopi yönteminin teorisi ve çalışmanın deneysel süreci anlatılmaktadır.

Beşinci bölümde deney sürecinde elde edilen verilerin empedans çalışması, RC devre çalışması ve iletkenlik çalışmasının sonuçları değerlendirilmektedir.

Altıncı ve son bölümde ise, sonuçlar ve öneriler yer almaktadır.

# BÖLÜM 2. METALİK CAMLARIN TANIMI, ÖZELLİKLERİ, ÜRETİM TEKNİKLERİ VE TARİHİ GELİŞİMİ

### 2.1. Metalik Camlarının Tanımı Ve Özellikleri

Metalik cam, adından da anlaşılacağı gibi metalle cam arasında, makro boyutta metale, mikro boyutta ise cama daha yakın bir malzemedir. Metaller gibi kristal yapıya sahip olmaması ya da başka bir deyişle, camlar gibi amorf yapıya sahip olması onun yapısal anlamda cam olarak kabul edilmesine neden olmaktadır. Pek çok üretim metodu olmasına rağmen tüm bu metotların temel mantığı, sıvı biçimdeki metal alaşımını, kristal yapı oluşumuna izin vermeyecek bir hızla katılaştırmadır. Yapının amorf durumda kalması için çok sayıda alaşım elementinden oluştukları da bilinir. Eriyik durumdaki metal alaşımı 10<sup>5</sup>-10<sup>10</sup> K/s'lik bir hızla soğutulursa düzensiz yapıda katılaşırlar. Bu camsı yapı, yarı kararlı fazdadır.



Şekil 2.1. Sıvı, cam ve katı fazlar için, hacmin sıcaklıkla değişimi [3]

Şekil 2.1 incelendiğinde, metalik camın, sıvı faz ile kristal faz arasında bir ara faz bölgesine düştüğü görülür. Ergimiş metal alaşım normal yollardan katılaştırılırsa, ergime sıcaklığı  $T_m$ 'de eriyiğin hacminde bir süreksizlik gözlenir. Kristallenme,  $T_m$ ' nin altında oluşmazsa, hızlı soğutulmuş metalin hacmi daha da azalır.  $T_{g1}$  sıcaklığı ile  $T_{g2}$  arasında soğuma hızı daha da artırılırsa bu durumda yapı camsı amorf karakterde kalır. Yalnızca cam geçiş sıcaklıklarının altındaki bölgelerde metalik cam yapısından bahsetmek mümkündür.  $T_g'$ de eriyiğin yapı bakımından durulma süresi, soğuma hızından daha uzun olduğu için eriyik düzensiz yapıda katılaşır. Dolayısıyla düzensiz yapı meydana gelir. Metalik camın yapısı "tamamen düzensizdir" denilemez çünkü atomlar arasında kimyasal bağlar olmak zorundadır.

ÖZELLİK	METALİK CAM	KRİSTAL ALAŞIM
Үарı	Amorf	Kristal
Bağ	Metalik	Metalik
Akma Dayanımı	Yüksek	Düşük
Sertlik	Yüksek	Düşük
Kırılma	Sünek	Sünek
Kırılma Dayanımı	Yüksek	Yüksek
Korozyon Direnci	Yüksek	Düşük
Optik Özellik	Opak	Opak
Elektriksel İletkenlik	Yüksek	Yüksek
Manyetik Özellik	Manyetik	Para-Ferro Manyetik

Tablo 2.1. Metalik camlar ile kristal yapılı malzemelerin karşılaştırılması [3]

Güntherodt'un 1985 yılında yaptığı çalışmalar sonucu oluşturduğu tabloda metalik camlarla, kristal alaşımlar arasında kapsamlı bir karşılaştırma yapılmıştır. (Tablo 2.1) Bu tablodan da görüleceği üzere kristal alaşımla metalik camların her ikisinin de bağ yapılarının metalik olması nedeniyle, kırılmaya karşı dayanıklılıkları yüksek ve kırılganlık yapıları sünektir. Böylece bu yapısal benzerlik her ikisinin de elektriksel iletkenliklerinin yüksek olmasını sağlar. Optiksel açıdan iki grup malzemenin de opak olması ise, bu metalik bağ yapısına sahip ancak amorf olan metalik cam grubu malzemenin camsı yapı sayılmasına neden olur. Metalik camlar, manyetik, mekanik ve elektriksel özelliklerinden dolayı teknolojide tercih edilen bir malzeme grubudur. Mekanik açıdan düşünüldüğünde, dayanıklı ve işlenmesi kolay malzemelerdir. Yüksek doyum indüksiyonu, yüksek permeabilitesi ve düşük histerizis kayıpları da tercih edilme nedenlerindendir. Diğer bir önemli özelliği de yüksek elektriksel direncidir ki, bu özellik AC çalışmalarında çok istenen bir özelliktir. Camsı yapı belli bir periyodikliğe sahip değildir ve doğrultulara göre farklılıklar gösterir. 1978 yılında Chaudhari ve Turnbull tarafından gerçekleştirilen gaz, sıvı, amorf ve kristal yapılı katının X-ışınları analizi, desenlerin birbirinden oldukça büyük farklılıklar taşıdığını göstermektedir.



Şekil 2.2. Gaz, sıvı, amorf ve kristal yapılı katının X-ışını deney sonuçlarından elde edilmiş  $I(\theta)$  şiddet piklerinin ve atomik pozisyonlarının şematik gösterimi [3]

Şekil 2.2 incelendiğinde; gazların X-ışını incelemesinde şiddet pikinin ortaya çıkmadığı görülür. Bu, gazlarda atomlar arası mesafenin çok büyük olmasından kaynaklanır. Sıvı ve amorf katıların X-ışını analizinde pikler olmasına rağmen çok keskin değildir. Komşu atomlar arasında küçük açı saçılmalarından kaynaklanan geniş pikler oluşur. Oysa kristal yapılı katıda keskin Bragg pikleri gözlenmektedir. Her bir pik farklı bir periyodikliği, bu şekilde de kristalin uzun mesafeli düzenli yapısının olduğunu gösterir [3].

#### 2.2. Metalik Cam Üretim Teknikleri

Metalik camın tanımından ve özelliklerinden bahsederken vurgulandığı gibi, üretimde temel olay, hızlı katılaştırmadır. Bunun haricinde mekanik alaşımlama, öğütme, lazer ve elektron ile bombardıman metodu gibi teknikler de kullanılır. Ancak bu üretim teknikleri yaygın değildir. Bu teknikler atomik yapıyı ve atom dizilişini bozduğu için metalik cam üretimi konusunda literatüre girmiştir. Ancak ekonomik ve seri üretime uygun olmamalarından dolayı tercih edilmezler. Bu nedenle bu bölümde yalnızca katılaştırma tekniklerinden bahsedilecek.

#### 2.2.1. Soğuk dönen disk metodları

Sıvı Metal Savurma ve Düzlemsel Akışlı Döküm olmak üzere iki farklı metodun genel adıdır. Bu metodlar, üretim şekilleri neredeyse aynı olmasına rağmen eriyiğin disk yüzeyine akma mesafesi farklı olduğu için iki farklı adla anılırlar.

#### 2.2.1.1. Sıvı metal savurma metodu



Şekil 2.3. Sıvı metal savurma metodu

Bu yöntemde sıvı metal içinde eritildiği potada bulunan bir delikten belirli açılarla soğuk disk üzerine püskürtülür. Bu eriyik yüzeye yayılarak soğuk yüzeyin etkisiyle aniden ince şerit halinde soğur. Üretilen malzemenin kalitesi, potanın tasarımı, deliğin çapı, sıvının akış hızı, eritme şekli, disk dönme hızı gibi özelliklere bağlıdır. Soğuma hızı 10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> K/s arasında değişmektedir. Metodun dezavantajı, potanın uç kısmının zaman zaman tıkanması yüzünden akış hızının istikrarlı olmaması ve çok dar şeritler elde edilebilmesidir. Bu dezavantajları yüzünden metod geliştirilmiş ve ortaya "Düzlemsel Akışlı Döküm Metodu" çıkmıştır [3].

#### 2.2.1.2. Düzlemsel akışlı döküm metodu



Şekil 2.4. Düzlemsel akışlı döküm metodu

Sıvı Metal Savurma metodunda yaşanan dezavantajlar göz önüne alınarak geliştirilmiş bir metoddur. İşleyiş mantığı bu metodla aynıdır. Farklarına bakılacak olursa, metal eriyiği yüksek frekanslı indüksiyon fırınında hazırlanır. Sıvı metal disk yüzeyine bir delikten değil dikdörtgen bir yarıktan sürücü kuvvet etkisiyle akıtılır. Potanın uç kısmı dikdörtgen olduğundan istenilen genişlikte şerit elde edilebilir. Ayrıca pota disk yüzeyine yakın olduğu için akış hızının kontrolü daha kolaydır. Böylece diğer yöntemin aksine şeritte sabit bir kalınlık, sabit genişlik ve sabit soğuma hızı sağlanabilmektedir. Bu metod endüstriyel çalışmalarda en çok tercih edilen yöntemdir [3].

#### 2.2.2. Sıvı metal çekme metodu



Şekil 2.5. Sıvı metal çekme metodu

Bu metod ile geniş şeritler elde etmek mümkündür. Ancak bu metodda Düzlemsel Akışlı Döküm Metodundan farklı olarak metal eriyiğinin akışı gaz basıncı etkisiyle değil, yerçekimiyle sağlanmaktadır. Metodun dezavantajı ise, şerit genişliğini sabit tutmanın güçlüğüdür [3].

#### 2.2.3. Sıvı metal üstten akıtma metodu



Şekil 2.6. Sıvı metal üstten akıtma metodu

Bu metod Sıvı Metal Çekme Metoduna benzemektedir. Metal eriyik disk yüzeyine kontrollü bir şekilde taşırılır. Eritme işlemi yine indüksiyon ile gerçekleştirilir. Soğuma hızı bunda da disk soğumasına ve dönme hızına bağlıdır [3].

### 2.2.4. Sıvı metal fırlatma metodu



Şekil 2.7. Sıvı metal fırlatma metodu

Bu metodda eritilen metal, bir havuzda toplanır. Diğer metodlardan farklı olarak bu metodda üretim, metal eriyiğine soğuk disk yaklaştırılarak yapılır. Düzenekte pota bulunmaz. Metal eriyiğin olduğu havuza dönen disk yaklaştırılır ve temas böyle sağlanır. Bu metodda aynı genişlikte ve kalınlıkta şerit üretmek çok zordur [3].

#### 2.3. Metalik Camların Tarihi Gelişimi

Metalik cam üretimi, güncel bir bilimsel gelişme olarak tanımlanmasına karşın bu çalışmalarla ilgili ilk duyumlarımız 1930'lara kadar uzanır. 1930 yılında metalik cam üretimi Brill ile anılmaktaydı. Bundan sonra 1934 yılında Kramer, metalik cam üretmeye çalıştı.

İlk metalik cam 1957 yılında  $Au_{80}Si_{20}$  alaşımından Pol Duwez tarafından Caltech'te üretildi. Bu ve diğer ilk metalik cam alaşımları kristal yapı oluşumunu önlemek için son derece hızla (10<sup>6</sup> K/s) soğutulmak zorundaydı. Bunun bir sonucu olarak metalik camların sahip olacağı formla ilgili pek çok kısıtlama vardı. Alaşımı planlanan sürede soğutabilmek için katı formun kalınlığı en fazla 100 mikrometre ile sınırlandı. Bu sınırlar dahilinde malzeme şerit, metal yaprak ya da tel formunda üretiliyordu.

1969 yılında % 77.5 paladyum, % 6 bakır ve % 16.5 silisyum alaşımının kristal oluşumunu önleyen kritik soğutma oranının 100 K/s ile 1000 K/s aralığında olduğu bulundu.

1976 yılında H. Lieberman ve C. Graham, süper soğutmalı hızlı bir çıkrıkta amorf metali ince şeritler halinde imal etmek için yeni bir metod geliştirdi. 1980'lerin başlarında ticari kullanıma sunulan ve "Metglass" olarak bilinen bu malzeme demir, nikel, fosfor ve bor alaşımıydı. Bu çalışma dahilinde üretilen Metglass-2605 % 80 demir ve % 20 bordan oluşur. 373 °C Curie sıcaklığına ve oda sıcaklığında 125.7 militesla magnetizasyona sahiptir.

1980'lerin başlarında metalik cam külçeler üretilmeye başlandı. % 55 Paladyum, % 22.5 grafit, % 22.5 antimondan oluşan alaşımdan 5 mm çapında metalik cam külçe üretildi.

1988'de lantanyum, aluminyum ve bakır alaşımlarının daha yüksek oranda cama dönüşme eğilimli alaşımlar olduğu tesbit edildi. 1990'larda saniyede 1 K'lik soğutmayla birkaç cm'lik kalınlığa sahip camlar oluşturan alaşımlar bulundu. 1992'de Caltech'te ilk ticari amorf alaşım üretildi. % 41.2 Zr, % 13.8 Ti, % 12.5 Cu, % 10 Ni ve % 22.5 Be'dan oluşan Vitreloy 1, NASA Enerji departmanının "atmosfer dışı yeni malzemeler" çalışmasının bir parçasıydı. Bunu daha farklı malzemeler izledi.

2004 yılında biri Oak Ridye Ulusal Laboratuvarı, diğeri Virjinya Üniversitesi olmak üzere iki grup, bulk metali, amorf çeliğe dönüştürmeyi başardı. Oda sıcaklığında manyetik olmayan malzeme geleneksel çelikten çok daha kuvvetliydi.

Son yıllarda bütün dünyada metalik camlar ve özellikleri hakkında birçok bilimsel toplantılar, konferanslar düzenlenmekte ve makaleler yayınlanmaktadır [4].

# BÖLÜM 3. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> İLE İLGİLİ YAPILMIŞ LİTERATÜR ÇALIŞMALARI

#### 3.1. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> ile İlgili Çalışmalara Genel Bakış

Çalışmanın bu kısmına kadar metalik cam malzeme grubu hakkında genel bilgiler verilmekle birlikte bundan sonraki kısımda  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  metalik camı üzerinde durulacaktır.

 $Fe_{78}Si_9B_{13}$ , üretiminden bu yana fizik, kimya ve malzeme bilimiyle uğraşan pek çok bilim adamı ve araştırma grubunun ilgisini çekmekle beraber bu konuda yayınlanan makale ve diğer çalışmalara bakıldığında araştırmaların daha çok, malzemenin manyetik, optik ve yapısal özellikleri ile ilgili olduğu görülmektedir.

# 3.1.1. Amorf metal alaşımı Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>'ün düşük frekanslı manyetik alanda davranışı

Bu çalışmada 10-40 Hz aralığındaki düşük frekanslı manyetik alanın amorf metal alaşımının mikro yapısı ve manyetik özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Uygulama süresi, 180-300 saniye arasında değiştirilirek işlem sonucu gerçekleşen ısı artışı, kızılötesi termometre ile ölçülür. Örneklerin kristalizasyonu ve mikro yapısı Mössbauer Spektroskopisi ve TEM ile incelenerek manyetik özellikleri AGM ile belirlenir.

Çalışmanın sonucunda  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  alaşımı, düşük frekanslı manyetik alanda, düşük sıcaklıkta gerçekleşen tek fazlı kristalizasyon gösterir. Nanokristal içerme, alaşımın kalan fazında görülür. Düşük frekanslı manyetik alanın amorf alaşımların manyetik özelliklerini geliştirdiği sonucuna varılır [5].



Şekil 3.1. Amorf metal alaşımı Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>'ün, manyetik alan uygulanmasından önceki ve sonraki Mössbauer Spektroskopisi [5]

# 3.1.2. Fe $_{78}$ Si $_{9}B_{13}$ alaşımının sülfat ve klorid çözeltisinde elektrokimyasal davranışı

Bu çalışmada Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>'ün elektrokimyasal korozyon davranışı farklı çözeltilerde karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Alaşımın 0.5 M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> ve 0.5 M NaCl solüsyonlarından oluşan aşındırıcı ortamdaki davranışı 20 °C, 35 °C ve 70 °C'de elektrokimyasal tekniklerle sınanmaktadır.

Çalışmanın sonucunda Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> alaşımının relaksasyon yapısı maddenin aşınma oranında azalmaya neden olur. Buna rağmen yapının hem klorid hem de sülfat çözeltisinde aşınma oranı 70 °C'de artar. 500 °C'den 550 °C'ye kadar değişen ısılarda alaşımın kısmî kristalizasyonu, amorf alaşımın önceki oranıyla karşılaştırıldığında aşınma sürecini hızlandırmada herhangi bir katkı sağlamaz [6].



Şekil 3.2. Farklı sıcaklıklarda 0.5 M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> içinde elde edilen  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  alaşımının korozyon oranı ve sıcaklığa bağımlılığı [6]



Şekil 3.3. 0.5 M Na<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> çözeltisi içinde  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  alaşımının 350-550 °C'de sıcaklık davranışı ve as-quenchede karşı gelen potansiyedinamik polarizasyon eğrisi [6]

# 3.1.3. Amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeridinin ısı artışı ve akım uygulamasında meydana gelen yapısal değişiklik

Bu çalışmada  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  şeridinin örnekleri farklı esnek baskılar altında izotermik bir şekilde ısıtılmış ve soğutulmuştur. Aynı örnekler ısı arttırma, DSC ve XRD metodları kullanılarak da incelenmiştir.

Çalışmanın sonucunda amorf  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  şeridinde akım ve ısı artışı ile 430 °C civarında yapısal değişim gözlenir. Esnek baskılı, ısıtılıp soğutulan XRD örnekleri ile baskısız örnekler karşılaştırıldığında esnek baskının kristalizasyonu etkilediği görülür [7].



Şekil 3.4. Farklı sıcaklıklarda ölçülen amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> as-quenched şeritlerinin DSC termogramı [7]



Şekil 3.5. Farklı sıcaklıklarda ölçülen amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> as-quenched şeritlerine ait DSC termogramının sol tarafı [7]



Şekil 3.6. Farklı sıcaklıklarda ölçülen amorf  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  as-quenched şeritlerinin termal genleşme eğrileri [7]



Şekil 3.7. Farklı sıcaklıklarda ölçülen amorf  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  as-quenched şeritlerinin termal genleşme katsayıları [7]

# 3.1.4. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> toz parçacıkları içeren nanokompozit polimerlerin ferromagnetik özellikleri

Bu çalışmada, amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeritleri yüksek enerjili küre şeklindeki öğütücü içerisinde öğütülüp, elde edilen metalik tozlar bir elekten geçirilmiş ve sonra bir saat süre ile 773 K'de, argon atmosferinde nanokristal durumuna getirmek ve öğütme sürecinin sebep olduğu baskıyı azaltmak için bekletilmiştir. Toz parçacıkları toroidal çekirdekler elde etmek için silikon polimerle karıştırılmıştır. Polimerleştirme işlemi, 500 A/m manyetik alan içerisinde yapılarak, metalik tozların manyetik özellikler üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

Çalışmanın sonucunda; parça ölçüsü artarsa tozun dayanıklılığı ve bileşik çekirdekler artar. Aynı zamanda polimer bileşiklerin yumuşak manyetik özellikleri kontrol edilebilir ve bileşikteki toz kütlesine, toz parçacıklarının şekline, ölçüsüne ve bileşikteki yönüne bağlıdır. Bu toz parçacıklarının 773 K'de bir saat süreyle argon atmosferinde bekletilmesiyle elde edilen toz halinde bulunan iki fazlı yapı manyetik özellikler açısından idealdir. Metalik toz oranının silikon polimerden fazla olduğu durumda oluşan bileşik çekirdeklerin manyetik açıdan daha güçlü olduğu anlaşılır. En iyi sonuçlar % 85.7 toz içeren bileşik çekirdeklerde görülür [8].



Şekil 3.8. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> elenmiş tozlarının A) 200-500 μm B) 75-200 μm C) 25-75 μm aralıklarında çekilmiş SEM fotoğrafları [8]



Şekil 3.9. Bileşik çekirdeklerin ters çevirici alanda toz taneciklerinin hacminin etkisi [8]



Şekil 3.10. Bileşik çekirdeklerin doyum indüksiyonunda toz taneciklerinin hacminin etkisi [8]



Şekil 3.11. Bileşik çekirdeklerin manyetik geçirgenliğinde toz taneciklerinin hacminin etkisi [8]
## 3.1.5. Amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>'ün farklı sabit sıcaklıklarda bekletilme sürecindeki durumu

Bu çalışmada, amorf  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  şeritleri kristalleşme derecesine kadar çeşitli sıcaklıklarda bekletilip, şeritteki faz dizisi ve kırılgan kanal oluşumundaki etkisi bekletilme süresince XRD ve SEM metodları kullanılarak incelenmiştir.



Şekil 3.12. Farklı soğutma süreçlerinde bekletilen amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeritlerinin XRD desenleri [9]

Çalışmanın sonucu, Fe<sub>3</sub>Si ve FeSi dizili yapılarının 200 °C - 300 °C arasında 15 dakikadan 15 saate kadar değişen sürede belirdiğini gösterir. Düşük ısı uygulaması boyunca demirle ilgili bileşenlerin ömrü yüksek ısıdakinden daha uzundur. Bununla birlikte LTR boyunca Fe<sub>3</sub>Si'nin ömrü FeSi'den daha uzunken HTR süresince çok daha kısadır. Daha detaylı FeSi'nin oluşum zamanı, Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> zincirinde kırılgan kanal oluşumunun kritik zamanına yakındır [9].

## 3.1.6. Sabit sıcaklıkta bekletilme sürecinde Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> amorf malzemesinin kırılganlığa geçişi

Bu çalışmada, Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> zincirinin örnekleri kristalleşme derecesine kadar çeşitli sıcaklıklarda bekletilerek eğme testi yapılmış ve numuneler XRD, DSC ve SEM kullanılarak çalışılmıştır.

Hem eğme testi hem de çatlak yüzeyler kırılgan kanallı dönüşümün 250°C ile 275°C arasında olduğunu gösterir. XRD tarafından görülen FeSi yapısı bu sıcaklıklar arasında oluşur. Bu değerler dışına çıkıldığı zaman kaybolur. Araştırmalar FeSi yapısının, şeridin kırılgan kanallı yapıya dönüşümünün kaynağı olduğunu gösterir [10].



Şekil 3.13. Soğutma sıcaklığı ve Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeridinin dış kenarının basınçla arasındaki ilişki [10]



Şekil 3.14. Gerilme baskısı uygulayarak kırılan amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeritlerinin kırılma yüzeylerinin SEM mikrografiği

i) Esnek durum : a) as-quenched b) 1 saat 200°C bekletilme durumunda c) 1 saat 250°C bekletilme durumunda

ii) Kırılgan durum : d) 1 saat 275°C bekletilme durumunda e) 1 saat 300°C bekletilme durumundaf) 2 saat 250°C bekletilme durumunda [10]

## 3.1.7. Farklı sabit sıcaklıklarda bekletilen Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> metalik camının manyetik yapısında ve mikro yapısında meydana gelen değişimlerin gözlemlenmesi

Bu çalışmada; metalik cam Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>'ün manyetik ölçümleri DC manyetometre kullanılarak yapılmıştır. Örnekler izotermik bir şekilde 773 K'de bekletilerek her bir adım için uygun süre verilmiştir. Her adımda bekleme süresine karşılık gelen manyetik alan ve bu alana bağlı oluşan manyetizasyon eğrileri çizilmiştir. Bu sıcaklıkta oluşan en küçük manyetik alan 1.6 A/m olarak ölçülür.

Bu çalışma, standart termal bekletme şartları altında, metalik camların domen yapısında gerçekleşen evrimin sistematik incelenmesini sağlar. Labirent alanlarının gelişimi yüzeysel kristalleşmenin başladığı andır. Çalışma aynı zamanda, ortaya

çıkan domen yapılarını direk gözlemleme fırsatı vererek kristalleşme aşamalarının metalik camların manyetik özelliklerine etkisini belirten diğer çalışmaları da destekler [11].



Şekil 3.15. METGLAS-2605 S2'nin 773K sabit sıcaklık altında bekletilme zamanına karşılık gelen  $H_c$  [11]



Şekil 3.16. 773K de bekletilen Fe78Si9B13 örneğinin as-recived M-H halkası [11]



Şekil 3.17. 773K de bekletilen Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> örneğinin XRD desenleri [11]



Şekil 3.18. As-cast  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  şeritlerinin tipik domen resimleri

- a) sabit sıcaklıkta bekletme işlemi öncesi
- b) sabit sıcaklıkta bekletme işlemi öncesi
- c) 3 dakika sabit sıcaklıkta bekletme işleminden sonra
- d) 10 dakika sabit sıcaklıkta bekletme işleminden sonra [11]



Şekil 3.19. 773K'de a) 35 dakika b) 50 dakika sabit sıcaklıkta bekletme işlemine tabî tutulan  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  metalik camının tipik manyetik domenleri [11]

### 3.1.8 Amorf Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeritlerinin nanokristalizasyon davranışı ve manyetik özellikleri

Bu çalışmada, polikristal, farklı grain büyüklüklerine sahip demir-silisyum-bor alaşımları değişik kristalizasyon metodları kullanılarak başarılı bir şekilde hazırlanmıştır. Hazırlanan ferromanyetik Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> şeritlerinin amorf durumu TEM, XRD, MS, DSC ile incelenerek, hassas manyetik ölçümler yapılmıştır.

 $Fe_{78}Si_9B_{13}$  amorf yapısının kristalizasyonu tamamlandıktan sonra iki temel faz gözlenir. DSC termal analizi ve MS kullanılarak Curie sıcaklığının ve kristalleşme derecesinin T<sub>c</sub>=708 K ve T<sub>x</sub>=803 K olduğu belirlenir. T<sub>x</sub> değeri DSC ölçüm sonuçlarıyla uyumludur. Farklı bekletilme sıcaklıklarındaki Mössbauer Spektrumu karmaşık atom düzenlemelerinin sebebinin demir çevresindeki yapısal eşitsizlik olduğunu gösterir [12].



Şekil 3.20. Farklı ısıtma oranlarında Fe $_{78}$ Si $_9$ B $_{13}$  amorf şeritleri için DSC eğrileri [12]



Şekil 3.21. 1K/min ısıtma oranı ve 0 Dopler hızında 10s için sıcaklığın fonksiyonunun ölçümü [12]



Şekil 3.22. Farklı bekleme sıcaklıklarından sonra  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  amorf şeritlerinin XRD desenleri [12]



Şekil 3.23. Çeşitli sıcaklıklarda Fe $_{78}$ Si $_{9}B_{13}$  amorf şeritlerinin Mössbauer Spektrumu [12]



Şekil 3.24. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> amorf şeridinin azaltılan sıcaklığa karşı azalan magnetizasyonu ve kristalizasyondan sonra oluşan kristalleşme fazları [12]

#### 3.1.9. Fe78-xMoxSi9B13 amorf alaşımlarının kristalizasyon çalışması

BU çalışmada, amorf  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  alaşımları içerisinde bulunan Fe atomlarının bir kısmının yerine Mo atomları yerleştirilerek elde edilen amorf alaşımların kristalleşme süreçleri araştırılmıştır.

Mo karışımlarının Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> alaşımındaki varlığı sürecin yavaşlamasına neden oldu ve tüm prosedürü değiştirir. Kristalleşme 3 adımda tamamlanır. İlk ikisi boyunca BCC Fe[Si,Mo] ve BCT ya da ortorombik Fe<sub>3</sub>[Si,Mo] fazları oluşur. Fe<sub>3</sub>[Si,Mo] bileşiği yarı kararlıdır ve gelişimi boyunca Fe[Mo] BCC ve Fe<sub>2</sub>B BCT parçalarına ayrılır. BCC Fe[Si,Mo] dendritleri ile karşılaştırıldığında [Fe,Mo]<sub>3</sub>B'nin histerisizi bor atomlarının demir atomlarına oranına bağlıdır. İkincisi arttığında histerisizler iki etkinin aynı anda gerçekleştiği noktaya kadar azalır [13].



Şekil 3.25. Karışımın atomik konsantrasyonu ve sıcaklığın fonksiyonu olarak metal alaşımının azaltılan doyma manyetizasyonu [13]



Şekil 3.26. Karışımın atomik konsantrasyonu ve sıcaklığın fonksiyonu olarak metal alaşımının elektriksel direncinin yüzde değişimi [13]



Şekil 3.27. 475°C de bekletilen metal alaşımlarının doyma manyetizasyonu [13]



Şekil 3.28. Çeşitli atomik konsantrasyonlarda Mo'in kristalleşme oranının sıcaklıkla değişimi [13]



Şekil 3.29. İlk kristalizasyonun aktivasyon enerjisi ve pro-exponansiyel sıklık faktörü [13]

### BÖLÜM 4. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> DENEYSEL SİSTEMİ VE ÖLÇME TEKNİĞİ

#### 4.1. Elektrokimyasal Empedans Kavramı

Elektrik akımına karşı direnme tüm devre elemanlarının bir yeteneğidir. Ohm Kanunu, bu temel üzerine kurularak, direnci; voltajın akıma oranı olarak tanımlar.

$$R = \frac{E}{I} \tag{4.1}$$

Her devre elemanına bir tür direnç gözü ile bakılabilir. İdeal bir direnç şu özelliklerle tanımlanır:

- Bütün akım ve voltaj değerlerinde Ohm Kanunuyla uyumludur.
- AC akım ve voltaj sinyali direnç üzerinde aynı fazdadır.

Gerçek dünya, çok daha fazla karmaşık davranışı sergileyen devre elemanları içerir. Bu elemanlar direncin basit düşüncesini geliştirmeyi gerektirir. Onun yerine daha genel bir devre parametresi olan empedans kullanılır. Direnç gibi empedans da, akıma direnme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Dirençten farklı olarak empedans sınırsızdır.

Elektrokimyasal empedans genellikle, bir elektrokimyasal hücreye AC ya da DC potansiyel uygulanarak ve hücre boyunca akım ölçülerek elde edilir. Hücrenin bir sinüsodial potansiyel ile uyarıldığı varsayılırsa; bu potansiyele cevap, bir AC akım sinyali olur. Bu akım sinyali Fourier serisinin bir toplamı olarak analiz edilebilir [14].

Elektrokimyasal empedans normalde küçük bir uyarı sinyali kullanılarak ölçülür. Bu işlem hücrenin cevabının pseudo-çizgisel gelecek şekilde uygulanır. Çizgisel ya da pseudo-çizgisel sistemde bir sinüsodial potansiyele cevap aynı frekansta ancak farklı fazda yine sinüsodial olacaktır.



Şekil 4.1. Sinüsodial bir sistemde sinüsodial akım yanıtı

Uyarı sinyali zamanın bir fonksiyonu olarak şu şekilde ifade edilir:

$$E(t) = E_0 \cos(wt) \tag{4.2}$$

Çizgisel bir sistemde yanıt sinyali yine zamanın bir fonksiyonu olarak:

$$I(t) = I_0 \cos(wt - \phi) \tag{4.3}$$

şeklinde ifade edilir.

Ohm Kanununa benzer bir ifadeyle sistemin empedansı şu ifadeyle hesaplanabilir:

$$Z = \frac{E(t)}{I(t)} = \frac{E_0 \cos(wt)}{I_0 \cos(wt - \phi)} = Z_0 \frac{\cos(wt)}{\cos(wt - \phi)}$$
(4.4)

Bu ifadenin grafiğini çizilirse; ortaya bir kapalı eğri çıkar. Bu eğri "Lissajous Eğrisi" olarak adlandırılır. Lissajous eğrisinin osiloskoplar aracılığıyla çizimi, frekans analizörlerinin kullanılmaya başlanmasından önceki dönemde bir empedans ölçüm tekniği olarak kabul edilmekteydi.



Şekil 4.2. Lissajous Eğrisi

$$\exp(j\phi) = \cos\phi + j\sin\phi \tag{4.5}$$

şeklindeki Euler denklemini kullanarak,

 $E(t) = E_0 \exp(jwt) \tag{4.6}$ 

$$I(t) = I_0 \exp(jwt - j\phi) \tag{4.7}$$

daha önce elde edilen denklem bu bağıntılardan yararlanarak geliştirilirse.

$$Z = \frac{E}{I} = Z_0 \exp(j\phi) = Z_0(\cos\phi + j\sin\phi)$$
(4.8)

denklemi elde edilir.

Bu denklem incelendiğinde ifadenin, biri reel diğeri imajiner olmak üzere iki kısımdan oluştuğu görülür. Reel kısma ait değerler x eksenine, imajiner kısma ait değerler y eksenine yerleştirilecek olursa ortaya Şekil 4.3'deki gibi bir yarım daire çıkar. Bu dairenin y ekseni negatiftir ve daire üzerindeki her nokta farklı bir frekansta empedanstır. Daire üzerinde sağdan sola gittikçe frekans azalır.



Şekil 4.3. Empedansın imajiner kısmının reel kısmına bağımlılığı

Yarım daire tek bir zaman sabitinin karakteristiğidir. Elektrokimyasal empedans çizimleri genellikle birkaç zaman sabitini içerir. Bu birbirini takib eden daireler olabileceği gibi, içiçe geçmiş daireler şeklinde de kendini gösterebilir.



Şekil 4.4. Tek zaman sabitli devrenin beklenen yanıt grafiği

#### 4.2 . Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> Metalik Camının Deneye Hazırlanması

Çalışmada Allied Corporation USA ve Vacuummschmelze Germany tarafından üretilen  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  metalik şerit kullanıldı. Örnekler makaralardan çalışmanın gerektirdiği ölçülerde kesildi. Tüm örnekler asetonla temizlenip, özel kurutma cihazlarında kurutuldu. Temizlenip kurutulan  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  örneklerinin en kusursuz (temiz, düzgün ve çiziksiz) bölümlerinden 20 mm genişliğinde, 50 mm uzunluğunda ve 20 µm kalınlığında şeritler alındı.



Şekil 4.5. Allied Corporation USA tarafından üretilen Fe78Si9B13 metalik cam şeridi

# 4.3. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> Metalik Camının Elektriksel Ölçümünde Kullanılan Deney Düzeneği

#### 4.3.1. Empedans analizörü

Electrochemical Impedance Spectoroscopy dataları üç elektrotlu PARSTAT 2273 empedans analizörü kullanılarak elde edildi. (Şekil 4.6 ve Şekil 4.7)



Şekil 4.6. Princeton Applied Research firması tarafından üretilen "PARSTAT 2273" adlı Empedans Analizörünün önden görünümü



Şekil 4.7. Princeton Applied Research firması tarafından üretilen "PARSTAT 2273" adlı Empedans Analizörünün arkadan görünümü

#### 4.3.2. Flat cell

PARSTAT 2273 analizöründe oluşturulan 1 kHz - 1 MHz frekans aralığındaki uyarımlar malzemeye A PAR K0235 Flat Cell kullanılarak iletildi. Bu iletim, birincisi Working Electrode (WE), ikincisi Saturation References Electrode (SLE), ve üçüncüsü Counter Elektrode (CE) olmak üzere 3 elektrot ile gerçekleştirildi.



Şekil 4.8. Princeton Applied Research firması tarafından üretilen "FLAT CELL" ünitesi

#### 4.3.3. Bilgisayar ve yazılım

Empedans analizörüne data kablosu ve USB girişi aracılığıyla bağlanan Windows işletim sistemli bilgisayara dataların aktarımı Princeton Applied Research firması tarafından üretilen PAR adlı yazılımın PowerSINE ve PowerCV bileşenleri kullanılarak gerçekleştirildi.



Şekil 4.9. Princeton Applied Research firması tarafından üretilen PowerSINE adlı yazılımın kullanıcı arayüzü

#### 4.4. Deneyin Uygulanması

Elektrolit sıvısı olarak kullanılan 0,1 M NaCl Flat Cell'in haznesine doldurularak mekanizma deneye hazırlandı. Ölçümler 1 kHz - 1 MHz frekans aralığında 0 Volt, 1 Volt, 2 Volt, 3 Volt, 4 Volt, 5 Volt, 6 Volt, 7 Volt, 8 Volt, 9 Volt ve 10 Voltluk gerilimler altında yapıldı.

Tutarlı bir sonuç alabilmek için her ölçüm en az üç kez tekrarlandı.

### **BÖLÜM 5. EMPEDANS ÖLÇÜMLERİ**

Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> metalik cam filminin elektriksel özellikleri oda sıcaklığında 1 kHz - 1 MHz frekans aralığında empedans spektroskopi yöntemiyle analiz edildi.

#### 5.1. Empedans Çalışması

Empedans spektrumu kazanç ve kayıp faktörleri göz önünde bulundurularak genellikle kompleks formda ifade edilir.

$$Z^{*}(w) = Z'(w) + iZ''(w)$$
(5.1)

Bir malzemenin frekansa bağımlı elektriksel özelliği "empedans" olarak tanımlanabilir [15]:

$$Z^{*}(w) = Z'(w) + iZ''(w) = \frac{1}{iC_{0}w\varepsilon^{*}(w)}$$
(5.2)

Formülde kullanılan  $C_0$ , geometrik kapasitans, *w* radyal frekans,  $\varepsilon^*(w)$  ise kompleks dielektrik sabitidir. Bu ifadeden hareketle ölçülen malzemenin dielektrik sabitinin de reel ve imajiner kısımlarının frekans bağımlılığı bulunabilir.

Bu ifade düzenlenerek reel ve imajiner kısımları ayrılarak dielektrik sabitin reel kısmı (5.3) formülüyle hesaplanabilir.

$$\varepsilon'(w) = -\frac{Z''(w)}{wC_0 \left(Z'^2 + Z''^2\right)}$$
(5.3)





Şekil 5.1'de empedansın reel kısmının frekansa bağımlılığı incelendiğinde empedansın uygulanan DC voltaja ve frekansa bağlı olduğu açıkça görülmektedir. Empedansın reel kısmının değerinin uygulanan elektromanyetik dalganın frekansı arttıkça azalma eğilimi göstermesi genel bir davranıştır. Bu davranış polarizasyon ile açıklanabilir. Şekilde düşük frekanslarda görülen düzlük bölgede empedans, uygulanan tüm DC voltajlardan ve frekanstan bağımsızdır. Bunun sonrasında bir azalma eğiliminin oluşu daha da sonrasında pek açık olarak gözükmese de yeni bir düzlük belirtisi, bu frekans aralığında bir relaksasyonun varlığını göstermektedir. Yüksek frekanslardaki uç bölgede oluşan düzlüğün tam olarak görünmemesi, kullanılan cihazın bu frekanslardaki yeteneğinin eksikliğinden kaynakalanır. Ayrıca, uygulanan bias voltaj arttıkça çok az değişim gösteren relaksasyon frekansının daha yüksek değerlere kaydığı şekilde görülmektedir.

Incelenen frekans aralığında bir relaksasyonun varlığı, empedansın imajiner kısmının frekans bağımlılığından (Şekil 5.2) daha net biçimde görülmektedir. Uygulanan bias voltaj arttıkça relaksasyon frekansının daha yüksek değerlere kaydığı da görülmektedir. Ancak artan Bias voltaj ile kayıpların hemen hemen değişmediği pik yüksekliklerinin sabit kalmasından anlaşılabilir.





Dielektrik şiddet uygulanan herbir DC voltaj için deneysel sonuçlardan  $\Delta \varepsilon = \varepsilon_0 - \varepsilon_{\infty}$ ifadesi kullanılarak elde edildi.  $\varepsilon_0$  ve  $\varepsilon_{\infty}$ , sırasıyla düşük ve yüksek frekanslarda dielektrik sabitlerdir.

Dielektrik şiddet, tüm Bias voltajlar için yüksek frekanslarda korunur. Δε parametresi dipol karakteristiği ile ilgilidir. Bu ilgi;

$$\varepsilon_0 - \varepsilon_\infty \approx \frac{N p^2}{3kT}$$
(5.4)

şeklinde formülize edilir [16].

 $\Delta \varepsilon = \varepsilon_0 - \varepsilon_\infty$  değerinin DC voltajın artmasıyla arttığı Şekil 5.3'de açıkça görülmektedir. Bu durum, uygulanan DC voltajın dipolün dönüşünü kolaylaştırmasından kaynaklanır. Yani DC voltaj arttıkça dönen dipollerin sayısı artar. Bunun sonucu olarak, dielektrik şiddet, DC voltajın artmasıyla daha yüksek bir değer alır. Ayrıca dielektrik sabit değeri frekans azaldıkça artar, maksimumuna ulaştıktan sonra daha yüksek frekanslarda imajiner kısım kaybolur.





#### 5.2. RC Devre Çalışması

Malzemelerin tanımlanması için kullanılan Empedans Spektroskopisi oldukça yeni bir tekniktir ve 10<sup>-6</sup>-10<sup>9</sup> Hz frekans aralığındaki fonksiyonların empedans analizini gerçekleştirebilecek yetenektedir. Bu metodun en önemli özelliklerinden biri, sistemin verdiği cevaplar arasında doğrudan bir bağıntı ortaya koymasıdır. EIS'da elde edilen kompleks empedans datalarını yorumlayabilmek için devre parametrelerini (kapasitans ve direnç) elde etmek ve dataları bir eşdeğer devre ile temsil etmek gerekir [17].

Direnç (R), dielektrik cevabın kayıp bileşenini temsil etmek için alınır. Kapasitans (C) ise malzemenin depolama bileşenini temsil eder. Serbest yüklerin taşınmasını ve belirli bir frekans aralığında polarizasyonu düşünürsek, bir RC devresi durum için elverişli bir modeldir. Bu devrenin toplam empedansı, kapasitans ve direnç katkılarının toplamı ile verilir [18].



Şekil 5.4. R-C Eşdeğer Devre Modeli

Elektriksel eşdeğer devre modeli kullanılarak  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  metalik cam filminin empedansının analiz edilebilmesi için relaxasyon mekanizmasının incelenmesi gerekir.

Bu relaxasyon durumu (5.5) denklemi ile ifade edilir:

$$Z^{*}(w) = Z'(w) + iZ''(w) = R_{s} + \frac{R_{p}}{1 + (iwCR_{p})^{1-\alpha}}$$
(5.5)

 $0 \le \alpha < 1$  relaxasyon zamanının dağılımı ya da beklenen değerden sapmanın bir ifadesidir. İfadedeki *C*, double-layer kapasitans,  $R_s$  çözeltinin resistansı,  $R_p$ , paralel resistans, w ( $w = 2\pi f$ ) radyal frekanstır.

Eğer  $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$  şeklindeki Euler formülü kullanılarak, denklem (5.5) düzenlenirse [19],

$$Z'(w) = R_s + \frac{R_p \left[ 1 + \left( wCR_p \right)^{1-\alpha} \cos\left( \left( 1 - \alpha \right) \frac{\pi}{2} \right) \right]}{1 + 2 \left( wCR_p \right)^{1-\alpha} \left( wCR_p \right)^{2(1-\alpha)} \cos\left( \left( 1 - \alpha \right) \frac{\pi}{2} \right)}$$
(5.6)

$$Z''(w) = R_s + \frac{R_p \left[ \left( w C R_p \right)^{1-\alpha} \sin\left( \left( 1-\alpha \right) \frac{\pi}{2} \right) \right]}{1 + 2 \left( w C R_p \right)^{1-\alpha} \left( w C R_p \right)^{2(1-\alpha)} \cos\left( \left( 1-\alpha \right) \frac{\pi}{2} \right)}$$
(5.7)

formülleri elde edilir.

Bu ifadeleri empedansın imajiner kısmının radyal frekansa göre diferansiyelinin sıfır olduğunu  $\frac{\partial Z''(w)}{\partial w} = 0$  düşünerek geliştirirsek,

$$\frac{\partial Z''(w)}{\partial w} = \frac{R_p (1-\alpha) \tau_0 (w \tau_0)^{-\alpha} \cos\left(\frac{\alpha \pi}{2}\right)}{\left[1+2 (w \tau_0)^{1-\alpha} \sin\left(\frac{\alpha \pi}{2}\right) + (w \tau_0)^{2(1-\alpha)}\right]^2} \left[1-(w \tau_0)^{2(1-\alpha)}\right]^2}$$
(5.8)

elde edilir.

 $\tau_0$ , relaxasyon zamanı olarak bilinir ve  $\tau_0 = CR_p$  ifadesiyle hesaplanır.

Formül (5.8) işlemlerde kısaca  $1 - (w\tau_0)^{2(1-\alpha)} = 0$  şeklinde kullanılabilir.

Şekil 5.4'de görülen elektriksel devrenin parametreleri deneysel empedans datalarının yukarıdaki denklemlere fit edilmesinden hesaplanabilir.  $Fe_{78}Si_9B_{13}$ metalik cam sistemi için *C* ve *R* değerleri formül (5.6), (5.7) ve (5.8) den hesaplandığında, film yapısının RC eşdeğer devresine uygunluğu görülür. Şekil 5.1 ve 5.2 incelendiğinde de paralel RC devresinin bu malzeme için ideal bir model olduğu kesinleşir. Fit işleminden elde edilen parametreler Tablo 5.1'de görülmektedir.

 $\alpha$ 'nın değerlerinin 0.228 ile 0.149 aralığında değişmesi, relaksasyon dağılımının genişliğini gösterir.

Bias Voltajı (V)	0	2	5	10
$R_p(\Omega)$	36.75	38.77	40.28	41.84
$R_{s}\left(\Omega ight)$	7.36	9.15	9.49	9.38
<i>C</i> (F)	1.97x10 <sup>-6</sup>	$3.27 \times 10^{-6}$	$3.16 \times 10^{-6}$	$3.06 \times 10^{-6}$
α	0.228	0.147	0.149	0.149

Tablo 5.1. Fe78Si9B13 için Fit işlemi ile Elde Edilen Parametreler

#### 5.3. İletkenlik Çalışması

Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> için farklı DC voltajlarında iletkenliğin frekansa bağlı değişim grafiği Şekil 5.5'de verilmiştir. AC iletkenlik davranışı ölçülen frekans aralığında düşük frekans düzlüğü ve yüksek frekans bölgesi dağılımı şeklinde iki ayrı bölge olarak belirgin bir şekilde görülmektedir. Düşük frekans bölgesinde elektromanyetik dalganın enerjisi az olduğu için, iletkenliğe katkı verecek taşıyıcılar için yeterli enerjiyi sağlayamamaktadır. Bu nedenle düz bir iletkenlik bölgesi ortaya çıkar. Yüksek frekanslarda enerjinin artması ile daha çok taşıyıcı iletkenliğe katkı verir ve iletkenlik de frekansla birlikte artışa geçer.



Şekil 5.5. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> için farklı DC voltajlarında iletkenliğin frekansa bağımlılığı

Malzemenin iletkenliğinde 100 kHz den sonra başlayan bu artış Şekil 5.5'deki DC iletkenlik düzlüğünün bittiği dispersiyon bölgesinin frekansı, karakteristik frekans olarak tanımlanır ve  $w_p$  hoplama frekansı olarak bilinir. Frekansa bağımlı iletkenlik Jonscher kanunu ile analiz edilebilir [20].

$$\sigma(w) = \sigma_{DC} + Aw^s \tag{5.9}$$

burada *A* sabit olup *s* ile gösterilen üs, sıcaklık ve voltaja bağlı olarak malzemeden malzemeye farklılık gösteren karakteristik bir parametredir. Bu üs hareketli iyonların etkileşim derecesini göstermektedir. Formül (5.9) ile deneysel datalar fit edildiğinde, *s* parametresi  $0.739 \pm 0.083$  bulundu. DC iletkenliğin, iletkenlik ekseninin ekstrapolasyon ile belirlenen değeri ~0.054 S/m dir. İletkenlik deney sonucu CBH (Coraleted Barrier Hopping) modeline uygun bir davranış gösterir. CBH modeline göre iletkenlik şu şekilde ifade edilir [21]:

$$\sigma(w) = \frac{\pi^2 N^2 \varepsilon}{24} \left( \frac{8e^2}{\varepsilon W_m} \right) \frac{w^s}{\tau^\beta}$$
(5.10)

*e* elektronun yükü,  $\varepsilon$  dielektrik sabit,  $W_m$  elektronların sıçarayabileceği maksimum bariyer yüksekliği,  $\tau$  ise fonon relaksasyon zamanıdır. Formüldeki *s* parametresi,

$$s = 1 - \beta \tag{5.11}$$

olup  $\beta$  parametresi ise,

$$\beta = \frac{6k_B T}{W_m} \tag{5.12}$$

şeklinde ifade edilir.

İletkenliğe katkı verecek e'ların zıplama mesafesi için,

$$R = \frac{e^2}{\pi \varepsilon_0 \varepsilon \left[ W_m - k_B T \ln\left(\frac{1}{w\tau_0}\right) \right]}$$
(5.13)

ifadesi kullanıldı [22].

Hesaplamalar yapılırken  $\tau$  değeri literatürde fonon titreşim frekansı olarak öngörülen  $10^{-13}$  s olarak alındı.

Frekansa bağlı iletkenlik formülünün deneysel datalarla fitinden elde edilen sayısal değerler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

ε	S	β	$W_m$	Ν	R
7.8	0.739	0.261	0.58	$5.93 \times 10^{25} \text{ eV}^{-1} \text{.cm}^{-3}$	1.27°A

Tablo 5.2. Frekansa bağlı iletkenlik formülünün deneysel datalarla fitinden elde edilen parametreler

### **BÖLÜM 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER**

Özetle, amorf metalin Bias voltaj altında ve 1 kHz – 1 MHz frekans aralığında empedans spektroskopi analizi gerçekleştirildi ve elde edilen datalar ile "Empedans", "RC Devre" ve "İletkenlik" çalışmaları yapıldı.

Empedansın reelve imajiner kısımlarının frekansa bağımlılığı (Şekil 5.1 ve 5.2) incelendiğinde, empedansın uygulanan DC voltaja ve frekansa bağlı olduğu gözlendi. Empedansın reel kısmının değerinin frekans arttıkça azalma eğilimi göstermesi beklenen bir davranıştı. Ayrıca 0 V-10 V aralığında uygulanan Bias voltajın artmasıyla empedansın arttığı tesbit edildi. Uygulanan Bias voltaj arttıkça oluşan relaksasyon frekansının daha yüksek değerlere kaydığı görüldü.

Elde edilen kompleks dataların daha iyi yorumlanabilmesi için malzeme bir eşdeğer devre ile modellendi. (Şekil 5.4) Serbest yüklerin taşınmasını ve belirli bir frekans aralığında polarizasyonu düşünülerek, bir RC paralel devresi önerildi. Deneysel empedans datalarının modele uygun denklemlerle fit edilmesiyle ortaya çıkan sonuç, film yapısının karşılık geldiği paralel RC eşdeğer devresinin karakteristik parametreleri hesaplandı.

İletkenliğin frekansa bağlılığı (Şekil 5.5) incelendiğinde, malzemenin iletkenliğinde 100 kHz'den sonra başlayan bir artış gözlendi. İletkenlik düzlüğünün bittiği dispersiyon bölgesinin frekansı, karakteristik frekans olarak tanımlanarak bu frekansın 100 kHz civarında olduğu belirlendi ve bunun  $w_p$  hoplama frekansına karşılık geldiği düşünüldü. Frekansa bağımlı iletkenlik Jonscher yasası kullanılarak analiz edildiğinde malzemenin iletkenliğinin frekansla değişimi "Bir Enerji Bariyerinden Zıplama ile Özdeşleşmiş İletkenlik Modeli (CBH)"ne uygun bir davranış gösterdiği belirlenerek modeli açıklayan parametreler belirlendi. Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> metal cam filminin elektriksel özellikleri oda sıcaklığında incelendi. Aynı çalışmaların düşük ve yüksek sıcaklıklar için de yapılması malzemenin elektriksel özelliklerinin tam olarak karakterize edilebilmesi için yararlı olacaktır.

Ayrıca elektrik alana bağlı polarizasyon eğrisi ya da akımın ve kapasitansın bias voltaja bağlı değişimi de  $Fe_{78}Si_9B_{13}$  metal cam filmi için yapılması önerilen diğer çalışmalardır.

#### KAYNAKLAR

- [1] Bilim ve Teknik Aylık Popüler Bilim Dergisi, Tübitak, Sayı 464, Syf. 16 Temmuz 2006
- Bilim ve Teknik Aylık Popüler Bilim Dergisi, Tübitak, Sayı 453, Syf. 4
   Ağustos 2005
- [3] RECEP ŞAHİNGÖZ, Metalik Cam Üretimi, Elektrik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi, Doktora Tezi, 1996, Ankara
- [4] Handbook of Advanced Magnetic Materials. David J. Sellmyer, Yi Liu, D.Shindo, Tsinghua University Press, ISBN 1402079834, 9781402079832
- [5] Y.H. ZHANG, Y. S. CHAO, Treatment of low-frequency pulsating magnetic field on amorphous alloy Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub>, Materials Science and Engineering, 460-461(2007)251-254
- [6] D. SZEWIECZEK, A. BARON, G. NAWRAT, Electrochemical behavior of Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> alloy in sulphate and chloride solution, Journal of Materials Processing Tecnology, 175(2006)411-415
- Y. C. NİU, X. F. BİAN, W. M. WANG, S. F. JİN, X. J. LİU, J. Y.
   ZHANG, G. L. QİN, The use of flow behavior and thermal expansion to monitor structural change of amorphous Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> ribbon, Journal of Non-Crystalline Solids 351(2005)3854-3860
- [8] R. NOWOSIELSKI, J. J. WYSLOCKI, I. WNUK, P. SAKIEWICZ, P. GRAMATYKA, Ferromagnetic properties of polymer nanocomposites containing Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> powderparticles, Journal of Materials Processing Tecnology, 162-163(2005)242-247
- Y. C. NİU, X. F. BİAN, W. M. WANG, X. B. QİNG, G. F. WANG, The order evolution in amorphous Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> ribbon during annealing process, Materials Letters, 59(2005)1589-1594

- [10] Y. C. NIU, X. F. BIAN, W. M. WANG, Origin of ductile, brittle transation of amorphous Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> ribbon during low temperature annealing, Journal of Non-Crystalline Solids, 341(2004)40-45
- [11] RECEP ŞAHİNGÖZ, MUSTAFA EROL, MIKE R. J. GIBBS, Observation of changing of magnetic properties and microstructure of metallic glass Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> with annealing, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 27(2004)74-78
- XİANGCHENG SUN, A. CABRAL-PRIETO, M. JOSE YACAMAN, J.
   REYES-GASGA, R. HERNANDEZ-REYES, A. MORALES,
   WENSHENG SUN, Nanocristallization behavior and magnetic properties of amorphous Fe<sub>78</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> ribbons, Physica B, 291(2000)178-179
- K. G. EFTHIMIDIAS, S. C. CHADJİVASİLİOU, E. K.
   POLYCHRONİADİS, M. ÖZER, G. A. STERGİOUDİS, I. A.
   TSOUKALAS, Study of the crystallization of Fe<sub>78-x</sub>Mo<sub>x</sub>Si<sub>9</sub>B<sub>13</sub> amorphous alloys, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 185(1998)187-193
- [14] Impedance Spectroscopy; Theory, Experiment, and Applications, 2nd ed.,
   E. Barsoukov, J.R. Macdonald, eds., Wiley Interscience Publications,
   2005.
- [15] V.M. Silva, S.K. Mendiratta, L. Pereira, Journal of Non-Crystalline Solids 352 (2006)1652–1655
- [16] C. Elisade and J. Ravez, J. Mater. Chem., (2001), 11, 1957-1967
- [17] J.R. MacDonals, Impedance Spectroscopy, Wiley, New York, 1987
- [18] Juana Benavente, Jose M. Garcia, Robert Riley, Angel E. Lozano, Javier de Abajo, Journal of Membrane Science 175 (2000) 43–52
- [19] E. McCafferty, Corrosion Science, Vol. 39, No.2, (1997), pp 243-254
- [20] A.K. Jonscher, Nature, 267, (1977), 673
- [21] W.-Y. Chung, J.-W. Lim, D.-D. Lee, N. Miura, N. Yamazoe, Sens. Actuators B 64 (2000) 118–123.
- [22] R.I. Mohamed, Journal of Physics and Chemistry of Solids 61 (2000)1357–1361
## ÖZGEÇMİŞ

Pınar ŞAHİN, 19.04.1973 de Aydın'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara'da, lise öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. 1990 yılında Bostancı Hayrullah Kefoğlu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık bölümüne girdi. 1994 yılında mezun olduktan sonra 2001 yılına kadar çeşitli Reklam Ajanslarında Metin Yazarı olarak görev yaptı.

2002 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünü 2006 yılında tamamladı. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans yapmaya başladı. Bu süre içerisinde çeşitli Özel Eğitim Kurumlarında Fizik dersleri verdi. Şu anda Fen Bilimleri Dershanesi'nde Fizik öğretmeni olarak görev yapmaktadır.